

## Descrizione del prodotto

Finitura: questa scheda deve essere placcata in oro a immersione secondo IPC-6012.  
Spessore deve essere. 050uM oltre 3-6uM nichel.

Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, dissecante messo nel fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del layer

L1-----Hoz

-PP 7Mil-

--

L2-----1

-COre 9,05 mil-

L3-----1

--

-PP 7mil-

L4-----Hoz

Definizioni livello:

- \*. GCMT-Top maschera di rivestimento conforme
- \*. GTP-pasta superiore della saldatura
- \*. GTO-serigrafia superiore
- \*. GTS-Top soldermask
- \*. GTL-strato superiore

-----

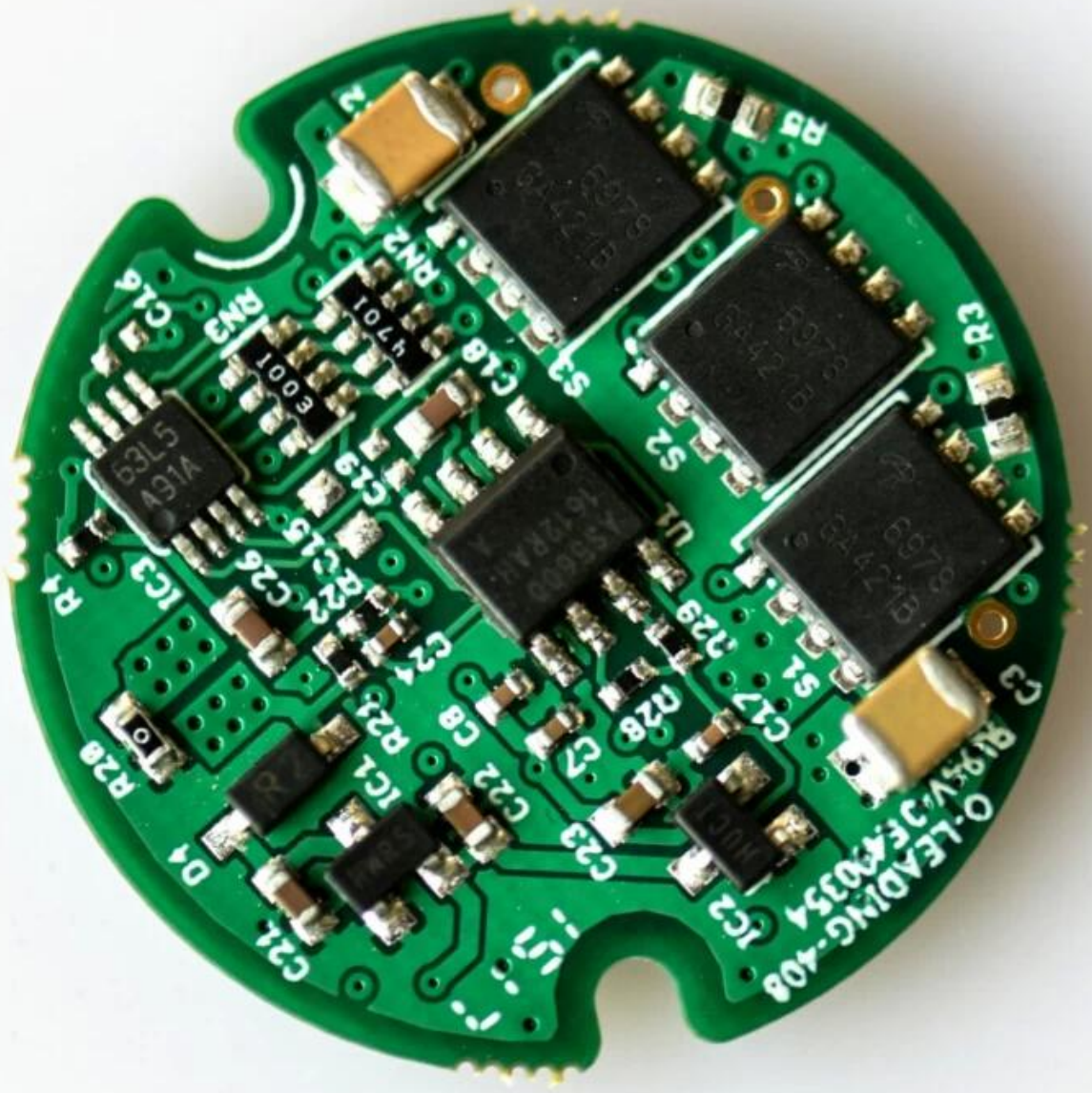
- \*. G2L-livello segnale interno 1

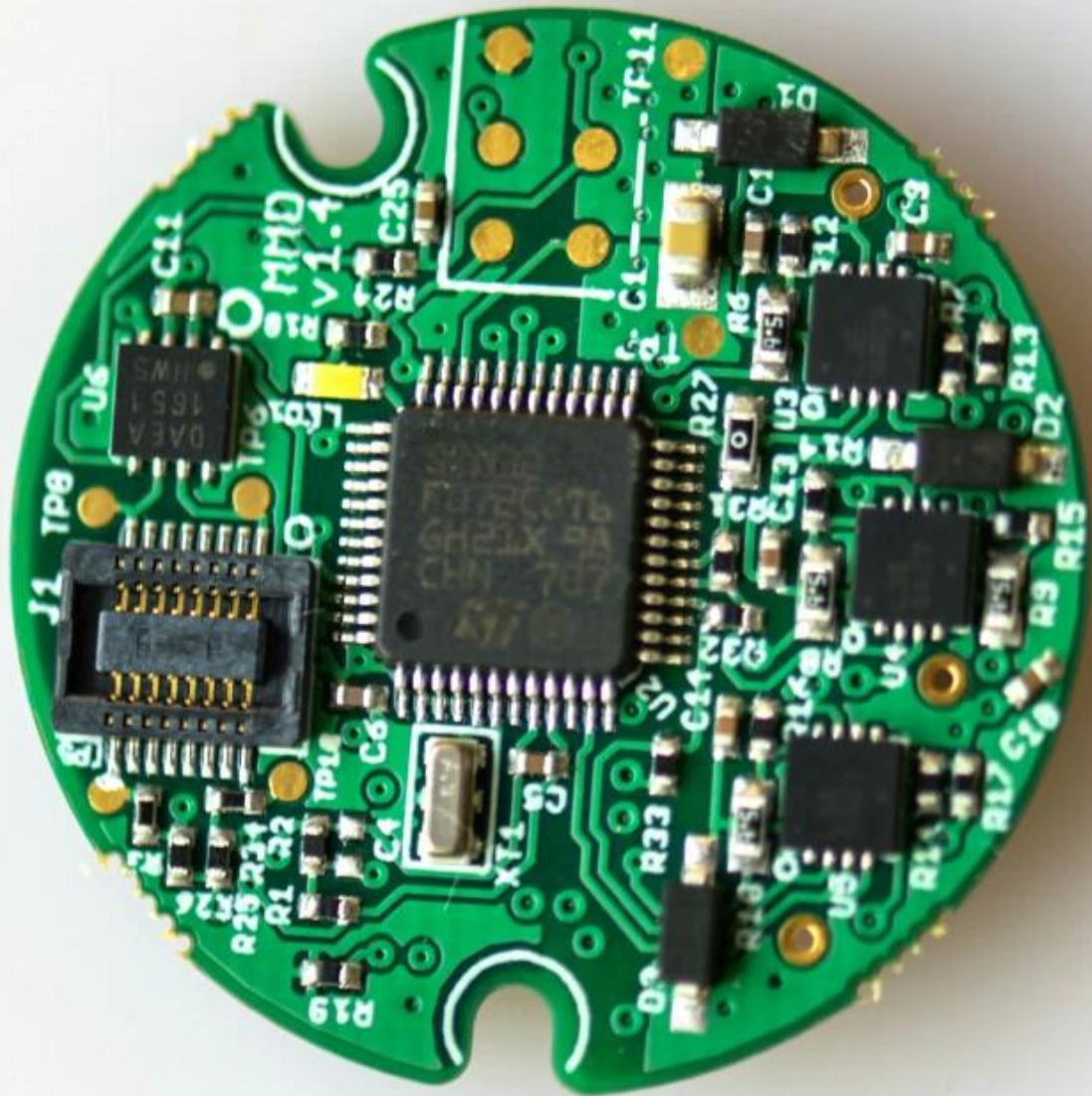
=====

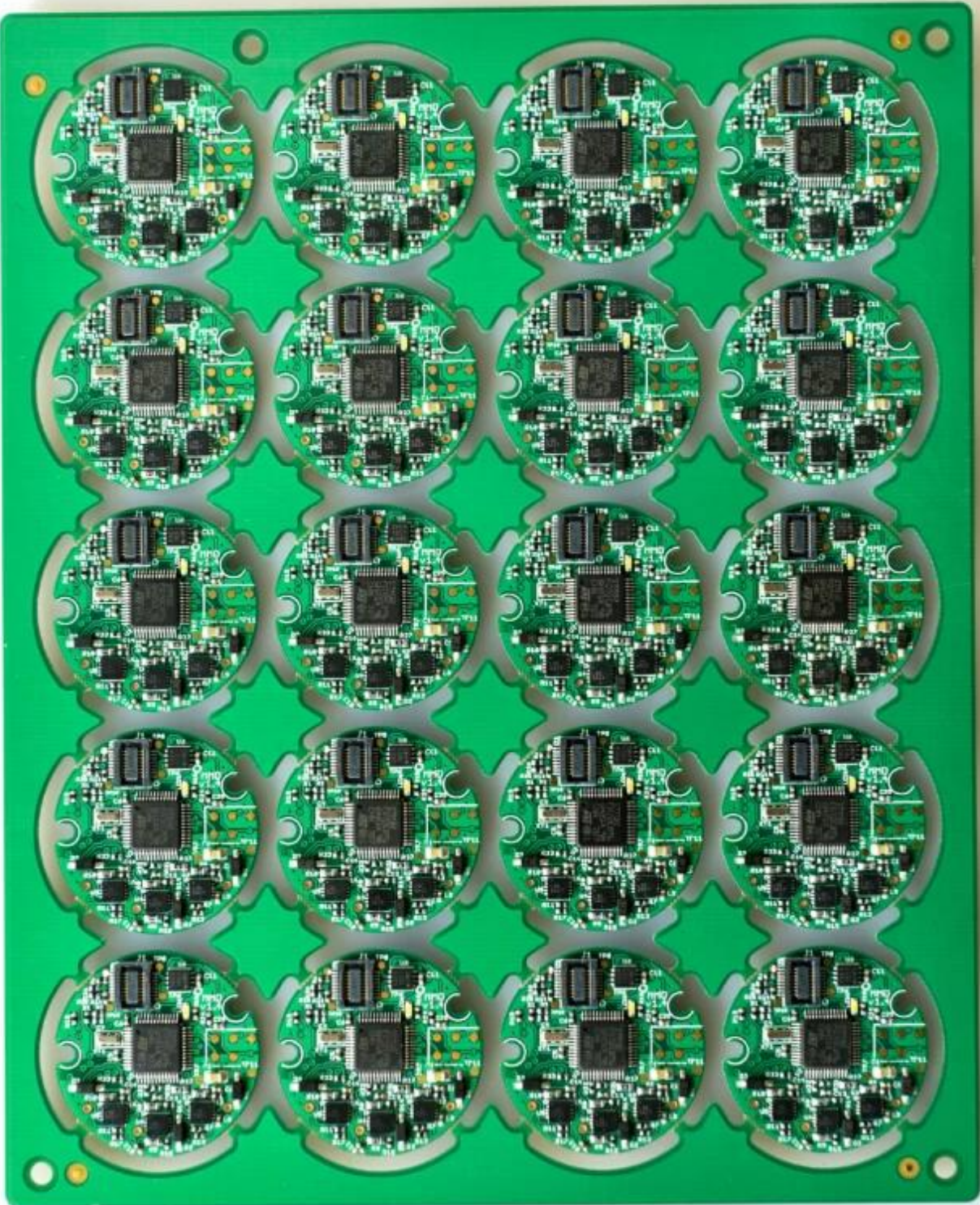
- \*. G3L-livello segnale interno 2

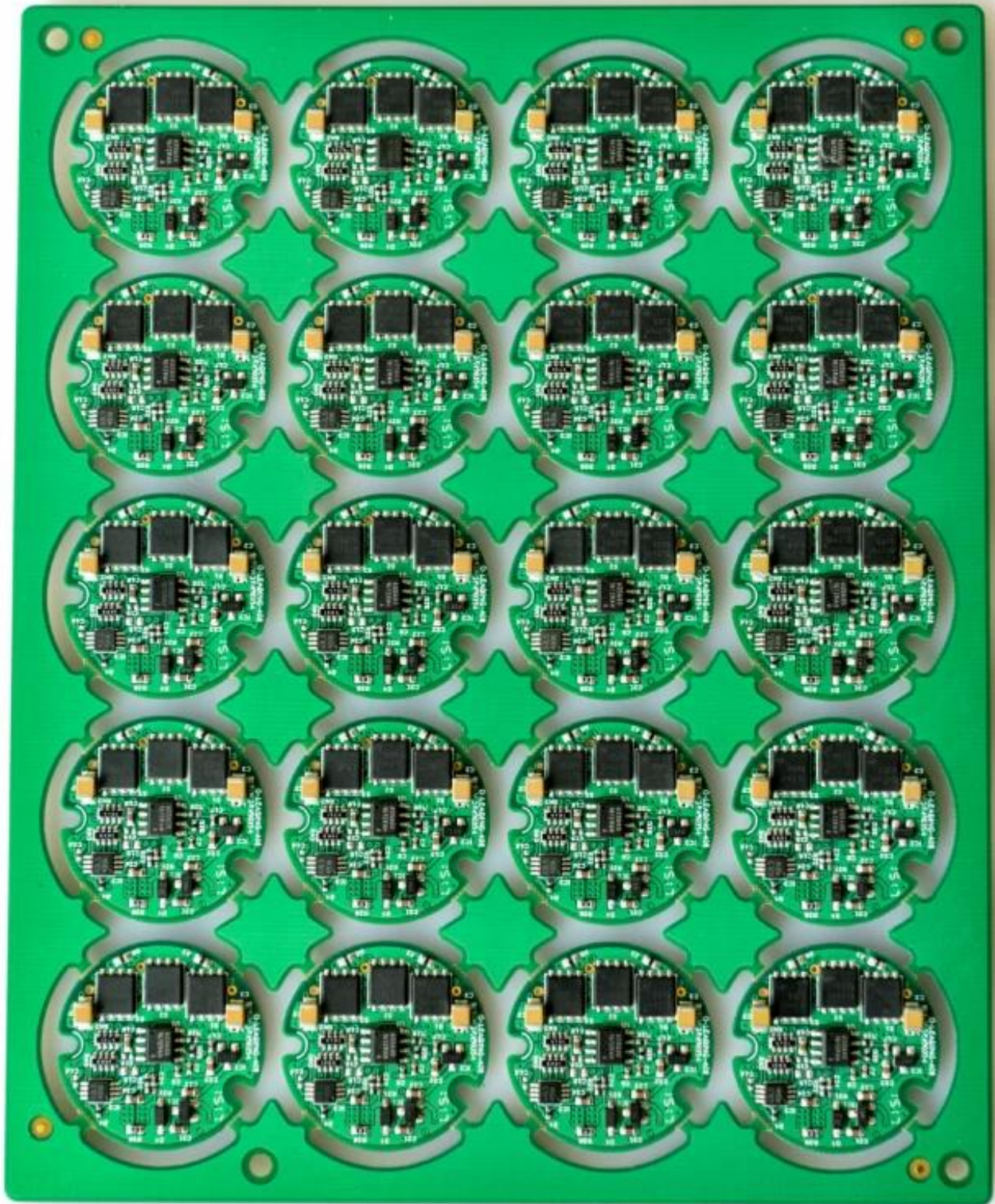
-----

- \*. GBL-strato inferiore
- \*. GBS-fondo soldermask
- \*. GBO-serigrafia inferiore
- \*. GBP-Bottom pasta di saldatura
- \*. GCMB-Bottom maschera di rivestimento conforme









[PCB prototipo fabbricante Cina](#)